



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106374055 A

(43)申请公布日 2017.02.01

(21)申请号 201610912009.9

(22)申请日 2016.10.19

(71)申请人 深圳市华星光电技术有限公司

地址 518132 广东省深圳市光明新区塘明
大道9—2号

(72)发明人 曾维静

(74)专利代理机构 深圳市德力知识产权代理事
务所 44265

代理人 林才桂

(51)Int.Cl.

H01L 51/56(2006.01)

H01L 51/52(2006.01)

H01L 27/32(2006.01)

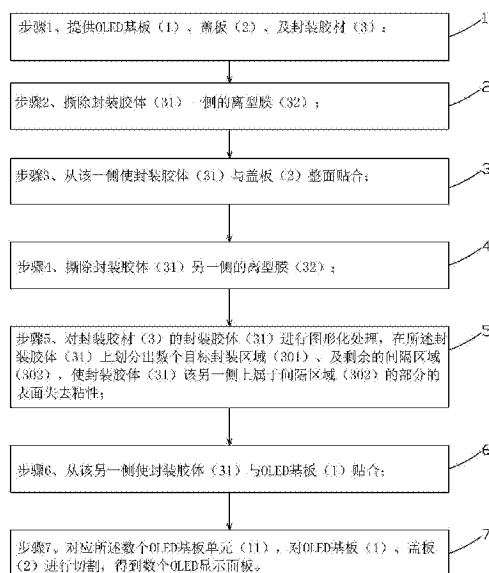
权利要求书2页 说明书6页 附图10页

(54)发明名称

OLED显示面板的制作方法

(57)摘要

本发明提供一种OLED显示面板的制作方法,首先对封装胶材的封装胶体进行图形化处理,在所述封装胶体上划分出数个与OLED基板上的数个OLED基板单元一一对应的目标封装区域、及剩余的数个目标封装区域之外的间隔区域,对所述封装胶体上属于间隔区域的部分进行表面破坏处理,而使该部分的表面失去粘性,然后再将封装胶体与OLED基板进行贴合,最后通过切割得到数个OLED显示面板,该方法简单易行,降低了贴合机的尺寸兼容性要求,以及避免了额外机械手、承载治具的使用,从而降低了治具清洗、传输、存放等复杂操作引起的设备巨额成本,提高了产品的对位贴合精度,可实现自动化。



1. 一种OLED显示面板的制作方法,其特征在于,包括:

提供OLED基板(1)、盖板(2)、及封装胶材(3)的步骤,其中,所述OLED基板(1)包括数个阵列排布的OLED基板单元(11),所述封装胶材(3)包括封装胶体(31)、及分别粘贴在该封装胶体(31)的相对两个侧面上的两层离型膜(32);

及对封装胶材(3)的封装胶体(31)进行图形化处理的步骤,其中,该步骤具体为,在所述封装胶体(31)上划分出数个与所述数个OLED基板单元(11)一一对应的目标封装区域(301)、及剩余的数个目标封装区域(301)之外的间隔区域(302),对所述封装胶体(31)上属于间隔区域(302)的部分进行表面破坏处理,从而使该部分的表面失去粘性。

2. 如权利要求1所述的OLED显示面板的制作方法,其特征在于,具体包括如下步骤:

步骤1、提供OLED基板(1)、盖板(2)、及封装胶材(3);

步骤2、撕除封装胶体(31)一侧的离型膜(32);

步骤3、从该一侧使封装胶体(31)与盖板(2)整面贴合;

步骤4、撕除封装胶体(31)另一侧的离型膜(32);

步骤5、对封装胶材(3)的封装胶体(31)进行图形化处理,在所述封装胶体(31)上划分出数个与所述数个OLED基板单元(11)一一对应的目标封装区域(301)、及剩余的数个目标封装区域(301)之外的间隔区域(302),从该另一侧对所述封装胶体(31)上属于间隔区域(302)的部分进行表面破坏处理,从而使该部分的表面失去粘性;

步骤6、从该另一侧使封装胶体(31)与OLED基板(1)贴合;

步骤7、对应所述数个OLED基板单元(11),对与封装胶体(31)贴合后的OLED基板(1)、及盖板(2)进行切割,得到数个OLED显示面板。

3. 如权利要求1所述的OLED显示面板的制作方法,其特征在于,具体包括如下步骤:

步骤1'、提供OLED基板(1)、盖板(2)、及封装胶材(3);

步骤2'、撕除封装胶体(31)一侧的离型膜(32);

步骤3'、对封装胶材(3)的封装胶体(31)进行图形化处理,在所述封装胶体(31)上划分出数个与所述数个OLED基板单元(11)一一对应的目标封装区域(301)、及剩余的数个目标封装区域(301)之外的间隔区域(302),从该一侧对所述封装胶体(31)上属于间隔区域(302)的部分进行表面破坏处理,从而使该部分的表面失去粘性;

步骤4'、从该一侧使封装胶体(31)与盖板(2)整面贴合;

步骤5'、撕除封装胶体(31)另一侧的离型膜(32);

步骤6'、从该另一侧使封装胶体(31)与OLED基板(1)贴合;

步骤7'、对应所述数个OLED基板单元(11),对与封装胶体(31)贴合后的OLED基板(1)、及盖板(2)进行切割,得到数个OLED显示面板。

4. 如权利要求1所述的OLED显示面板的制作方法,其特征在于,在对封装胶材(3)的封装胶体(31)进行图形化处理的步骤中,通过粒子束轰击的方式,对所述封装胶体(31)上间隔区域(302)的部分进行表面破坏处理,从而使该部分的表面失去粘性。

5. 如权利要求1所述的OLED显示面板的制作方法,其特征在于,在对封装胶材(3)的封装胶体(31)进行图形化处理的步骤中,通过紫外光照射的方式,对所述封装胶体(31)上间隔区域(302)的部分进行表面破坏处理,从而使该部分的表面失去粘性。

6. 如权利要求1所述的OLED显示面板的制作方法,其特征在于,在对封装胶材(3)的封

装胶体 (31) 进行图形化处理的步骤中,通过镭射扫描出所述封装胶体 (31) 上的数个目标封装区域 (301),并使得所述封装胶体 (31) 在目标封装区域 (301) 与间隔区域 (302) 之间产生隔断。

7.如权利要求2所述的OLED显示面板的制作方法,其特征在于,所述步骤3中,利用贴合机使封装胶体 (31) 与盖板 (2) 整面贴合。

8.如权利要求2所述的OLED显示面板的制作方法,其特征在于,所述步骤6中,在真空环境下完成封装胶体 (31) 与OLED基板 (1) 的贴合。

9.如权利要求3所述的OLED显示面板的制作方法,其特征在于,所述步骤4' 中,利用贴合机使封装胶体 (31) 与盖板 (2) 整面贴合。

10.如权利要求3所述的OLED显示面板的制作方法,其特征在于,所述步骤6' 中,在真空环境下完成封装胶体 (31) 与OLED基板 (1) 的贴合。

OLED显示面板的制作方法

技术领域

[0001] 本发明涉及平板显示技术领域,尤其涉及一种OLED显示面板的制作方法。

背景技术

[0002] 有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)显示器,具备自发光、高亮度、宽视角、高对比度、可挠曲、低能耗等特性,因此受到广泛的关注,并作为新一代的显示方式,已开始逐渐取代传统的液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD),被广泛应用于手机屏幕、电脑显示器、全彩电视等。OLED显示技术与传统的LCD显示方式不同,无需背光灯,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。但是由于有机材料易与水氧反应,很少量的水蒸气和氧气就能损害有机发光材料,使器件的发光性能劣化。因此,如何减少水蒸气和氧气对器件封装材料的渗透,消除器件内部的水蒸气和氧气,是有机电致发光器件封装技术要解决的重要问题。为了实现OLED显示面板商业化,与之相关的封装技术成为了研究热点。

[0003] 目前常用的OLED封装技术主要有:紫外光(UV)固化框胶封装、玻璃粉末镭射封装(laser sealing)、面封装(face seal)、框胶及干燥剂填充封装(dam and fill)、薄膜封装等。其中,面封装的封装方式常用于大尺寸的OLED显示面板上。为节省生产成本,一般会在高世代的玻璃基板上形成多个所需尺寸的面板,而采用面封装方式进行封装时,封装胶材的图形化成了一个亟需解决的难题。请参阅图1-6,目前采用面封装方式的OLED显示面板的制作方法包括以下步骤:

[0004] 步骤10、提供OLED基板100、数个盖板210、及数个封装胶材310,所述OLED基板100包括数个阵列排布的OLED基板单元110,每一封装胶材310包括封装胶体311、及分别粘贴在该封装胶体311的相对两个侧面上的两层离型膜312,其中,每一盖板210、及每一封装胶材310与OLED基板100上的单个OLED基板单元110相对应。

[0005] 步骤20、如图1所示,撕除每一封装胶体311一侧的离型膜312。

[0006] 步骤30、如图2所示,使用贴合机从该一侧使每一封装胶体311与一个盖板210对应贴合,进而将数个封装胶材310与数个盖板210对应贴合。

[0007] 步骤40、如图3所示,将数个已贴合好的封装胶材310与盖板210,通过机械手,一一放置在承载治具500上,其中,该数个已贴合好的封装胶材310与盖板210在承载治具500上的位置需要与所述OLED基板100上数个OLED基板单元110的位置一一对应。此时,该步骤对承载治具500的平坦度、机械手的控制精度、封装胶材310与盖板210在承载治具上的位置精度等要求较高。

[0008] 步骤50、如图4所示,撕除每一封装胶体311另一侧的离型膜312。

[0009] 步骤60、如图5所示,在所述承载治具500的承载下,从该另一侧使数个封装胶体311均与OLED基板100贴合,此时数个封装胶体311分别与OLED基板100上的数个OLED基板单元110一一对应贴合。

[0010] 步骤70、如图6所示,移除承载治具500,对应所述数个OLED基板单元110,对与所述

数个封装胶体311贴合后的OLED基板100进行切割,得到数个目标产品即OLED显示面板。

[0011] 在实际生产中,每一盖板210、及每一封装胶材310的尺寸均与目标产品的尺寸相对应,为兼容不同尺寸产品的生产,所述步骤30中所使用贴合机需要兼容不同尺寸的封装胶材100的贴合。

[0012] 另外,现有技术中,使用承载治具500承载数个已贴合好的封装胶材310与盖板210,然而承载治具500的使用,需要额外的传输、清洗、存放等操作,增加了设备成本,也使工艺变得复杂,使盖板210与OLED基板单元110的对位贴合精度降低。

发明内容

[0013] 本发明的目的在于提供一种OLED显示面板的制作方法,降低设备成本以及工艺难度,制作方法简单易行,可实现自动化生产。

[0014] 为实现上述目的,本发明提供一种OLED显示面板的制作方法,包括:

[0015] 提供OLED基板、盖板、及封装胶材的步骤,其中,所述OLED基板包括数个阵列排布的OLED基板单元,所述封装胶材包括封装胶体、及分别粘贴在该封装胶体的相对两个侧面上的两层离型膜;

[0016] 及对封装胶材的封装胶体进行图形化处理的步骤,其中,该步骤具体为,在所述封装胶体上划分出数个与所述数个OLED基板单元一一对应的目标封装区域、及剩余的数个目标封装区域之外的间隔区域,对所述封装胶体上属于间隔区域的部分进行表面破坏处理,从而使该部分的表面失去粘性。

[0017] 可选地,所述的OLED显示面板的制作方法具体包括如下步骤:

[0018] 步骤1、提供OLED基板、盖板、及封装胶材;

[0019] 步骤2、撕除封装胶体一侧的离型膜;

[0020] 步骤3、从该一侧使封装胶体与盖板整面贴合;

[0021] 步骤4、撕除封装胶体另一侧的离型膜;

[0022] 步骤5、对封装胶材的封装胶体进行图形化处理,在所述封装胶体上划分出数个与所述数个OLED基板单元一一对应的目标封装区域、及剩余的数个目标封装区域之外的间隔区域,从该另一侧对所述封装胶体上属于间隔区域的部分进行表面破坏处理,从而使该部分的表面失去粘性;

[0023] 步骤6、从该另一侧使封装胶体与OLED基板贴合;

[0024] 步骤7、对应所述数个OLED基板单元,对与封装胶体贴合后的OLED基板、及盖板进行切割,得到数个OLED显示面板。

[0025] 可选地,所述的OLED显示面板的制作方法,具体包括如下步骤:

[0026] 步骤1'、提供OLED基板、盖板、及封装胶材;

[0027] 步骤2'、撕除封装胶体一侧的离型膜;

[0028] 步骤3'、对封装胶材的封装胶体进行图形化处理,在所述封装胶体上划分出数个与所述数个OLED基板单元一一对应的目标封装区域、及剩余的数个目标封装区域之外的间隔区域,从该一侧对所述封装胶体上属于间隔区域的部分进行表面破坏处理,从而使该部分的表面失去粘性;

[0029] 步骤4'、从该一侧使封装胶体与盖板整面贴合;

[0030] 步骤5'、撕除封装胶体另一侧的离型膜；

[0031] 步骤6'、从该另一侧使封装胶体与OLED基板贴合；

[0032] 步骤7'、对应所述数个OLED基板单元，对与封装胶体贴合后的OLED基板、及盖板进行切割，得到数个OLED显示面板。

[0033] 在对封装胶材的封装胶体进行图形化处理的步骤中，通过粒子束轰击的方式，对所述封装胶体上间隔区域的部分进行表面破坏处理，从而使该部分的表面失去粘性。

[0034] 在对封装胶材的封装胶体进行图形化处理的步骤中，通过紫外光照射的方式，对所述封装胶体上间隔区域的部分进行表面破坏处理，从而使该部分的表面失去粘性。

[0035] 在对封装胶材的封装胶体进行图形化处理的步骤中，通过镭射扫描出所述封装胶体上的数个目标封装区域，并使得所述封装胶体在目标封装区域与间隔区域之间产生隔断。

[0036] 所述步骤3中，利用贴合机使封装胶体与盖板整面贴合。

[0037] 所述步骤6中，在真空环境下完成封装胶体与OLED基板的贴合。

[0038] 所述步骤4'中，利用贴合机使封装胶体与盖板整面贴合。

[0039] 所述步骤6'中，在真空环境下完成封装胶体与OLED基板的贴合。

[0040] 本发明的有益效果：本发明的OLED显示面板的制作方法，首先对封装胶材的封装胶体进行图形化处理，在所述封装胶体上划分出数个与OLED基板上的数个OLED基板单元一一对应的目标封装区域、及剩余的数个目标封装区域之外的间隔区域，对所述封装胶体上属于间隔区域的部分进行表面破坏处理，从而使该部分的表面失去粘性，然后再将封装胶体与OLED基板进行贴合，最后通过切割得到数个OLED显示面板，该方法简单易行，降低了贴合机的尺寸兼容性要求，以及避免了额外机械手、承载治具的使用，从而降低了治具清洗、传输、存放等复杂操作引起的设备巨额成本，并提高了产品的对位贴合精度，可实现自动化生产。

[0041] 为了能更进一步了解本发明的特征以及技术内容，请参阅以下有关本发明的详细说明与附图，然而附图仅提供参考与说明用，并非用来对本发明加以限制。

附图说明

[0042] 下面结合附图，通过对本发明的具体实施方式详细描述，将使本发明的技术方案及其他有益效果显而易见。

[0043] 附图中，

[0044] 图1为现有一种采用面封装方式的OLED显示面板的制作方法的步骤20的示意图；

[0045] 图2为现有一种采用面封装方式的OLED显示面板的制作方法的步骤30的示意图；

[0046] 图3为现有一种采用面封装方式的OLED显示面板的制作方法的步骤40的示意图；

[0047] 图4为现有一种采用面封装方式的OLED显示面板的制作方法的步骤50的示意图；

[0048] 图5为现有一种采用面封装方式的OLED显示面板的制作方法的步骤60的示意图；

[0049] 图6为现有一种采用面封装方式的OLED显示面板的制作方法的步骤70的示意图；

[0050] 图7为本发明的OLED显示面板的制作方法的第一实施例的流程示意图；

[0051] 图8为本发明的OLED显示面板的制作方法的第一实施例的步骤2的示意图；

[0052] 图9为本发明的OLED显示面板的制作方法的第一实施例的步骤3的示意图；

- [0053] 图10为本发明的OLED显示面板的制作方法的第一实施例的步骤4的示意图；
[0054] 图11为本发明的OLED显示面板的制作方法的第一实施例的步骤5的示意图；
[0055] 图12为本发明的OLED显示面板的制作方法的第一实施例的步骤6的示意图；
[0056] 图13为本发明的OLED显示面板的制作方法的第一实施例的步骤7的示意图；
[0057] 图14为本发明的OLED显示面板的制作方法的第二实施例的流程示意图；
[0058] 图15为本发明的OLED显示面板的制作方法的第二实施例的步骤2' 的示意图；
[0059] 图16为本发明的OLED显示面板的制作方法的第一实施例的步骤3' 的示意图；
[0060] 图17为本发明的OLED显示面板的制作方法的第一实施例的步骤4' 的示意图；
[0061] 图18为本发明的OLED显示面板的制作方法的第二实施例的步骤5' 的示意图；
[0062] 图19为本发明的OLED显示面板的制作方法的第二实施例的步骤6' 的示意图；
[0063] 图20为本发明的OLED显示面板的制作方法的第二实施例的步骤7' 的示意图。

具体实施方式

[0064] 为更进一步阐述本发明所采取的技术手段及其效果，以下结合本发明的优选实施例及其附图进行详细描述。

[0065] 请参阅图7，本发明的OLED显示面板的制作方法第一实施例，具体包括如下步骤：

[0066] 步骤1、提供OLED基板1、盖板2、及封装胶材3。

[0067] 其中，所述OLED基板1包括数个阵列排布的OLED基板单元11，所述封装胶材3包括封装胶体31、及分别粘贴在该封装胶体31的相对两个侧面上的两层离型膜32。

[0068] 步骤2、如图8所示，撕除封装胶体31一侧的离型膜32。

[0069] 步骤3、如图9所示，从该一侧使封装胶体31与盖板2整面贴合。

[0070] 具体地，所述步骤3中，利用贴合机使封装胶体31与盖板2整面贴合。

[0071] 具体地，由于步骤1中所提供的盖板2与封装胶材3均为整体对应OLED基板1，而非现有技术中与OLED基板1上的单个OLED基板单元11相对应，从而对于不同尺寸的目标产品，降低了贴合机的尺寸兼容性要求。

[0072] 步骤4、如图10所示，撕除封装胶体31另一侧的离型膜32。

[0073] 步骤5、如图11所示，对封装胶材3的封装胶体31进行图形化处理，在所述封装胶体31上划分出数个与所述数个OLED基板单元11一一对应的目标封装区域301、及剩余的数个目标封装区域301之外的间隔区域302，从该另一侧对所述封装胶体31上属于间隔区域302的部分进行表面破坏处理，从而使该部分的表面失去粘性。

[0074] 具体地，在对封装胶材3的封装胶体31进行图形化处理的步骤中，通过粒子束轰击的方式、或紫外光照射的方式，对所述封装胶体31上间隔区域302的部分进行表面破坏处理，从而使该部分的表面失去粘性。

[0075] 具体地，在对封装胶材3的封装胶体31进行图形化处理的步骤中，需要通过镭射扫描出所述封装胶体31上的数个目标封装区域301，其目的在于使得所述封装胶体31在目标封装区域301与间隔区域302之间产生隔断，从而使后续对盖板2的切割可以顺利进行。

[0076] 步骤6、如图12所示，从该另一侧使封装胶体31与OLED基板1贴合。

[0077] 具体地，所述步骤6中，在真空环境下完成封装胶体31与OLED基板1的贴合。

[0078] 具体地，所述步骤6中，封装胶体31的数个目标封装区域301与OLED基板1的数个

OLED基板单元11分别对应贴合。

[0079] 步骤7、如图13所示,对应所述数个OLED基板单元11,对与封装胶体31贴合后的OLED基板1、及盖板2进行切割,得到数个OLED显示面板。

[0080] 具体地,所述步骤7中,所述封装胶体31上属于间隔区域302的部分在对盖板2进行切割过程中,随同盖板2上需要被去除的部分一同去除;或者,

[0081] 在去除盖板2上需要被去除的部分之前,将所述封装胶体31上属于间隔区域302的部分剥离。

[0082] 请参阅图14,本发明的OLED显示面板的制作方法第二实施例,与上述第一实施例相比,主要区别在于,在使封装胶体31与盖板2整面贴合之前,先对封装胶体31进行图形化处理,具体地,本实施例包括如下步骤:

[0083] 步骤1'、提供OLED基板1、盖板2、及封装胶材3。

[0084] 其中,所述OLED基板1包括数个阵列排布的OLED基板单元11,所述封装胶材3包括封装胶体31、及分别粘贴在该封装胶体31的相对两个侧面上的两层离型膜32。

[0085] 步骤2'、如图15所示,撕除封装胶体31一侧的离型膜32。

[0086] 步骤3'、如图16所示,对封装胶材3的封装胶体31进行图形化处理,在所述封装胶体31上划分出数个与所述数个OLED基板单元11一一对应的目标封装区域301、及剩余的数个目标封装区域301之外的间隔区域302,从该一侧对所述封装胶体31上属于间隔区域302的部分进行表面破坏处理,从而使该部分的表面失去粘性。

[0087] 具体地,在对封装胶材3的封装胶体31进行图形化处理的步骤中,通过粒子束轰击的方式、或紫外光照射的方式,对所述封装胶体31上间隔区域302的部分进行表面破坏处理,从而使该部分的表面失去粘性。

[0088] 具体地,在对封装胶材3的封装胶体31进行图形化处理的步骤中,需要通过镭射扫描出所述封装胶体31上的数个目标封装区域301,其目的在于使得所述封装胶体31在目标封装区域301与间隔区域302之间产生隔断,从而使后续对盖板2的切割可以顺利进行。

[0089] 步骤4'、如图17所示,从该一侧使封装胶体31与盖板2整面贴合。

[0090] 具体地,所述步骤4'中,利用贴合机使封装胶体31与盖板2整面贴合。

[0091] 步骤5'、如图18所示,撕除封装胶体31另一侧的离型膜32。

[0092] 具体地,在所述步骤5'中,所述封装胶材3的封装胶体31已经进行过图形化处理,所述封装胶体31上属于间隔区域302的部分的表面粘性已被破坏,因此该部分在所述步骤5'中可与离型膜32一并被撕除,所述封装胶体31留在盖板2上的部分为属于目标封装区域301的部分。

[0093] 步骤6'、如图19所示,从该另一侧使封装胶体31与OLED基板1贴合。

[0094] 具体地,所述步骤6'中,在真空环境下完成封装胶体31与OLED基板1的贴合。

[0095] 具体地,所述步骤6'中,封装胶体31的数个目标封装区域301与OLED基板1的数个OLED基板单元11分别对应贴合。

[0096] 步骤7'、如图20所示,对应所述数个OLED基板单元11,对与封装胶体31贴合后的OLED基板1、及盖板2进行切割,得到数个OLED显示面板。

[0097] 综上所述,本发明的OLED显示面板的制作方法,首先对封装胶材的封装胶体进行图形化处理,在所述封装胶体上划分出数个与OLED基板上的数个OLED基板单元一一对应的

目标封装区域、及剩余的数个目标封装区域之外的间隔区域,对所述封装胶体上属于间隔区域的部分进行表面破坏处理,从而使该部分的表面失去粘性,然后再将封装胶体与OLED基板进行贴合,最后通过切割得到数个OLED显示面板,该方法简单易行,降低了贴合机的尺寸兼容性要求,以及避免了额外机械手、承载治具的使用,从而降低了治具清洗、传输、存放等复杂操作引起的设备巨额成本,并提高了产品的对位贴合精度,可实现自动化生产。

[0098] 以上所述,对于本领域的普通技术人员来说,可以根据本发明的技术方案和技术构思作出其他各种相应的改变和变形,而所有这些改变和变形都应属于本发明后附的权利要求的保护范围。

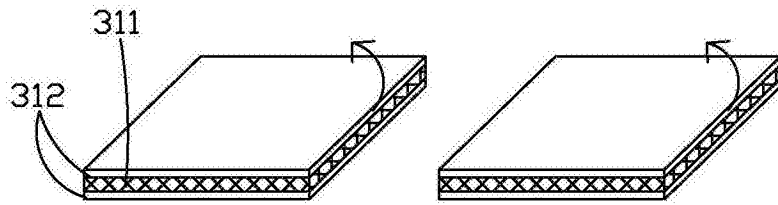


图1

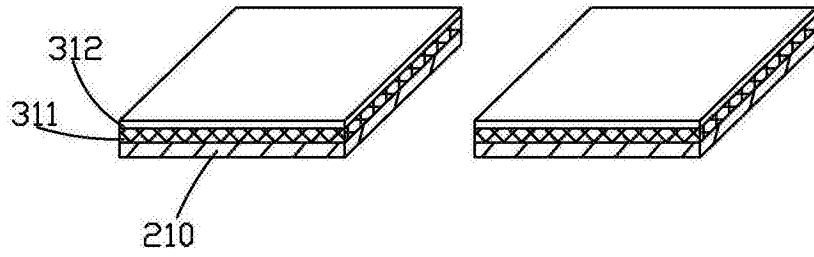


图2

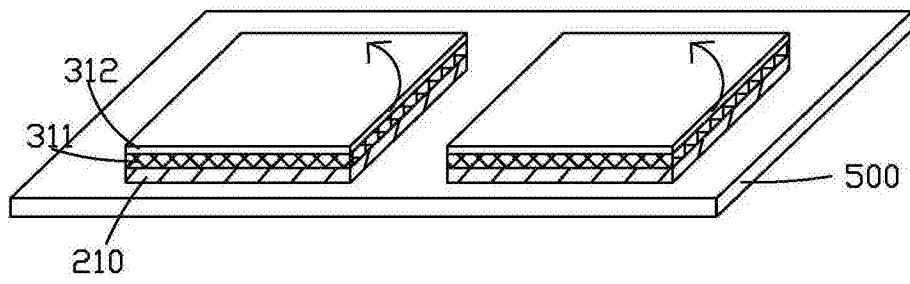


图3

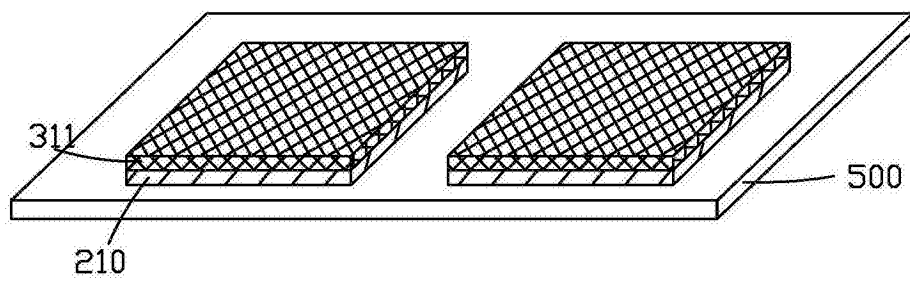


图4

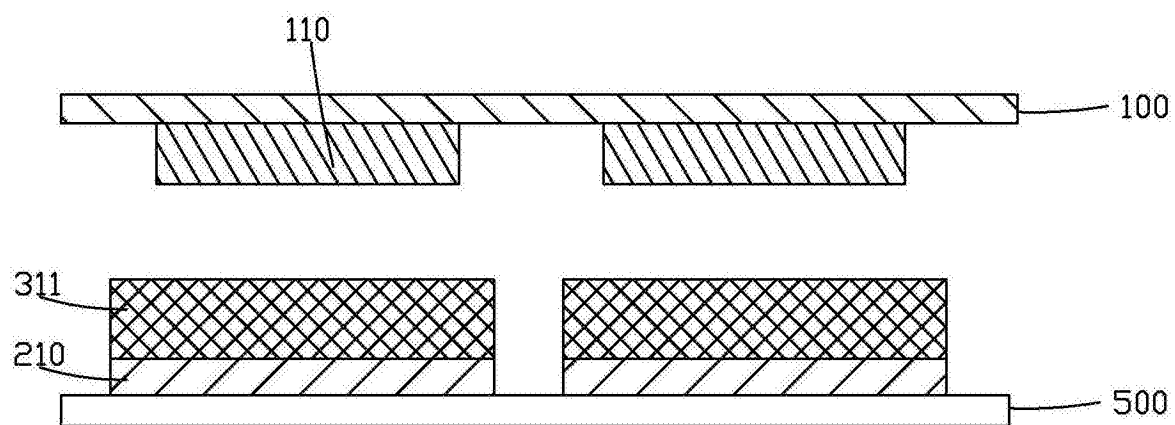


图5

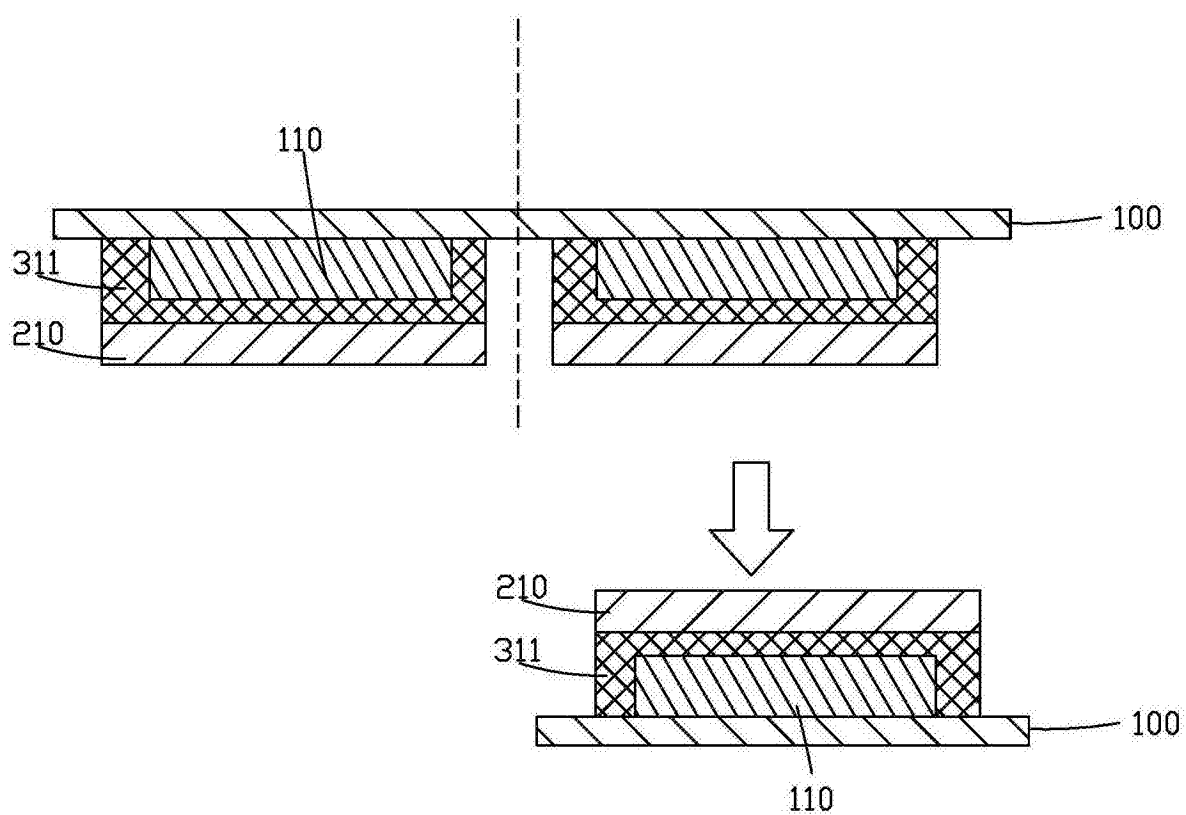


图6

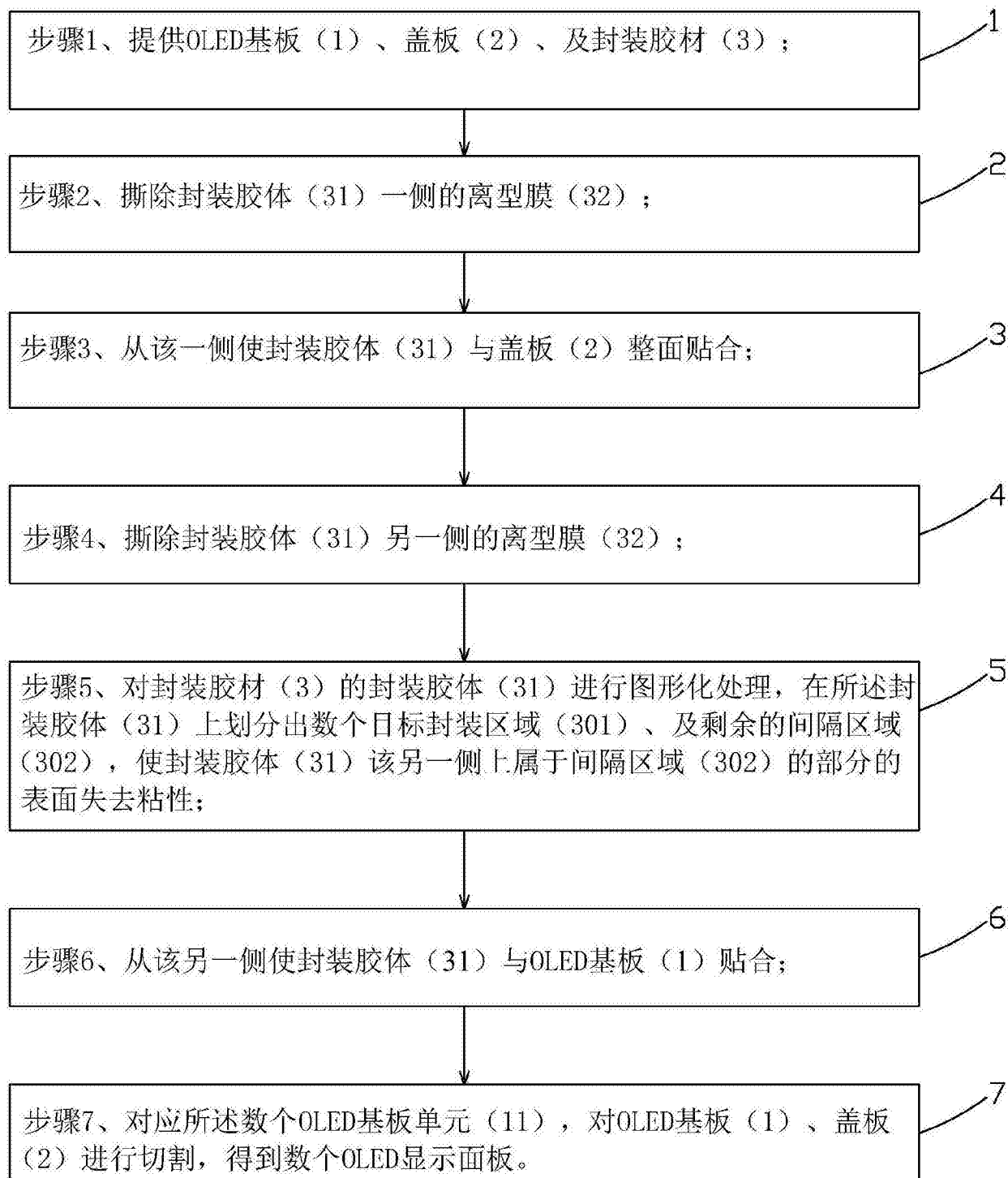


图7

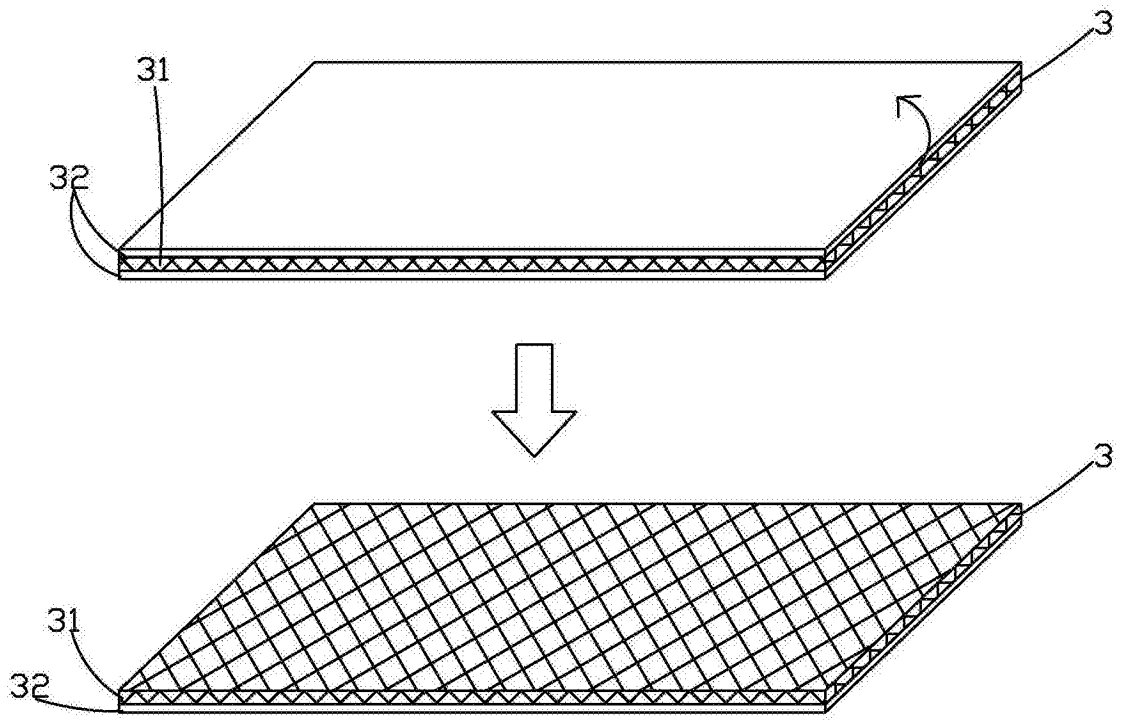


图8

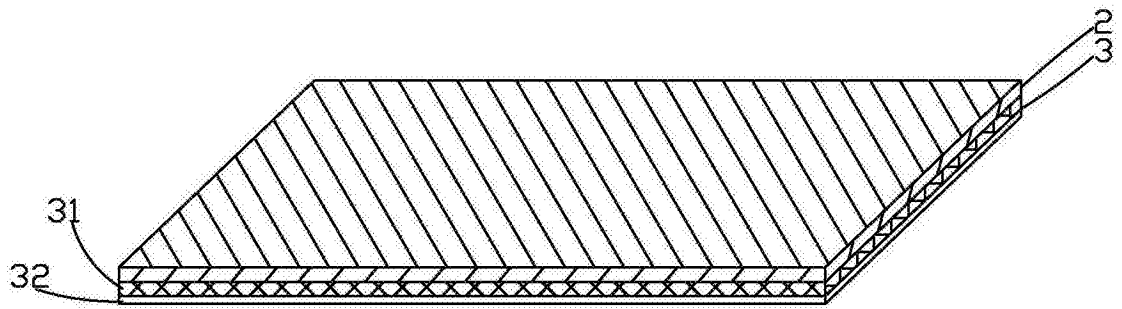


图9

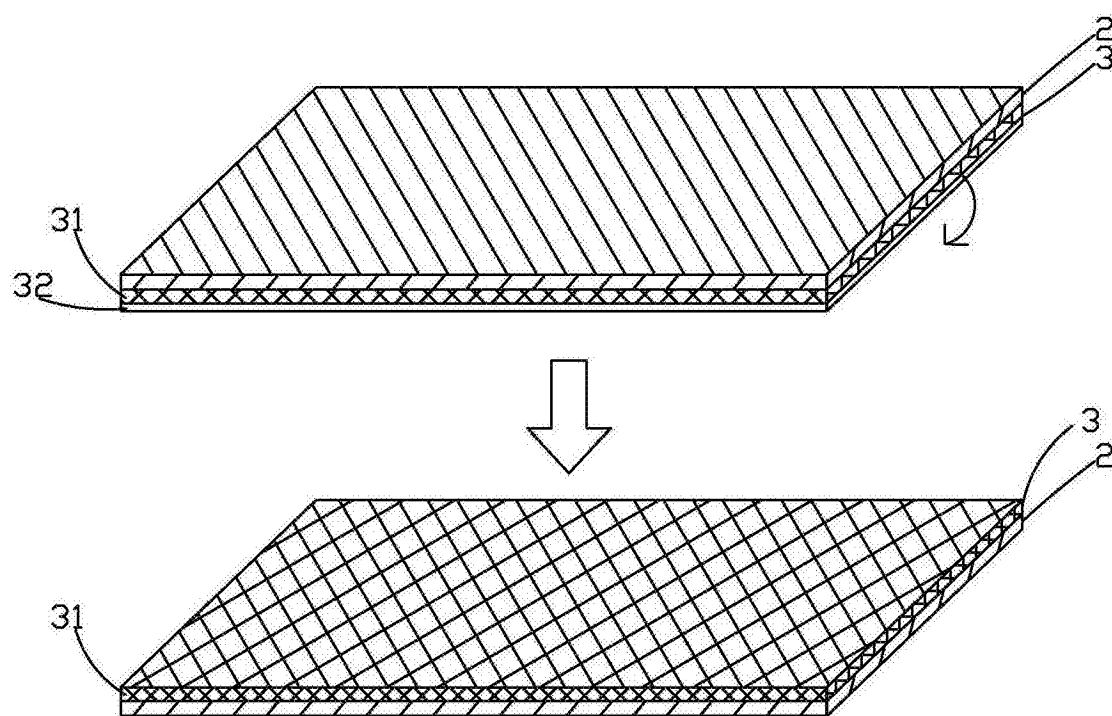


图10

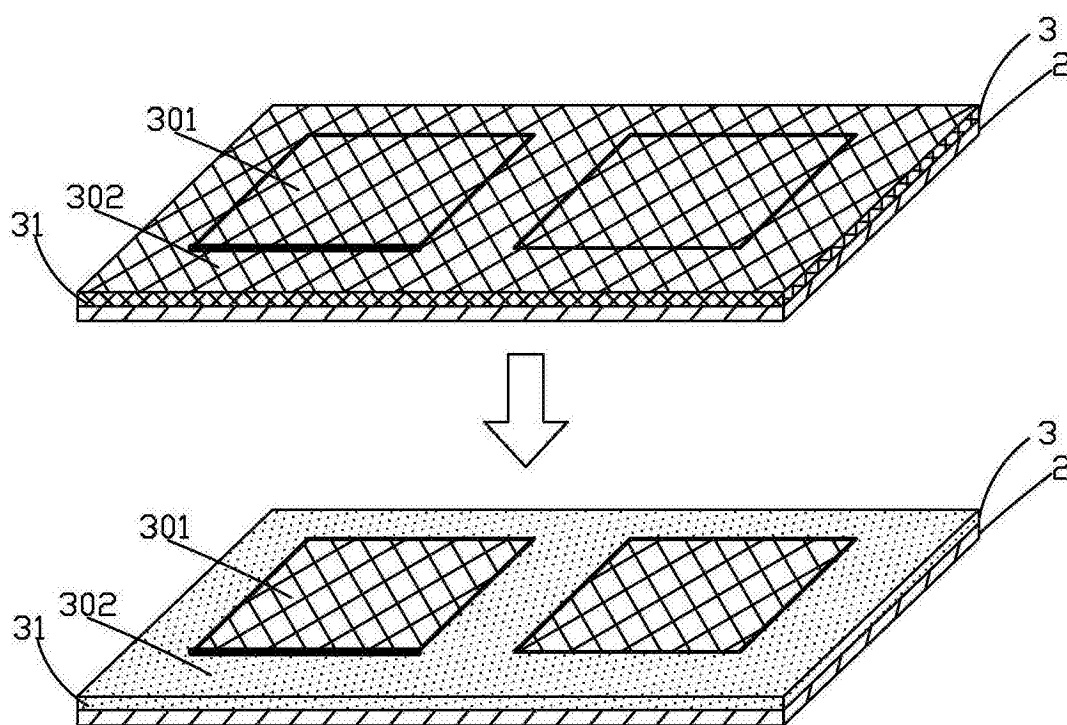


图11

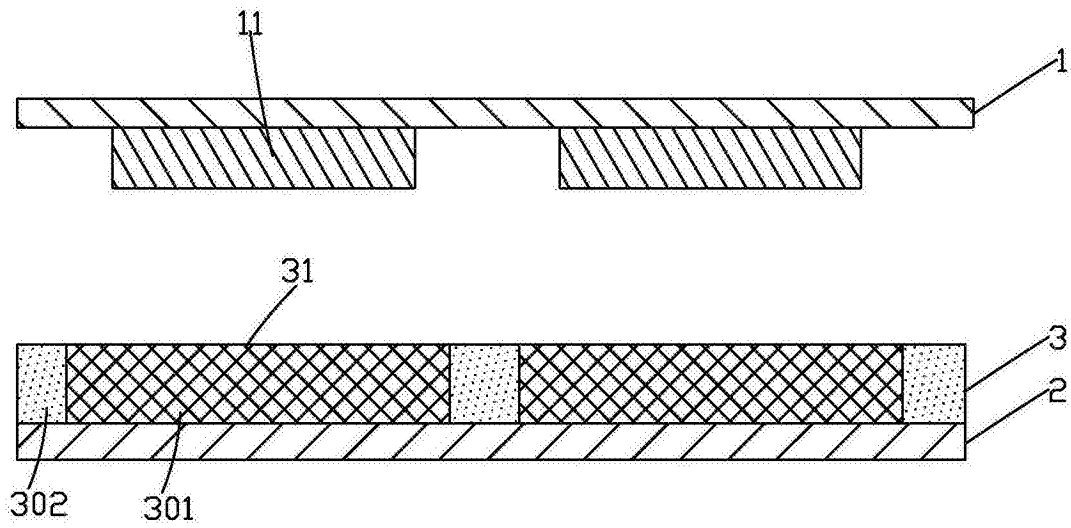


图12

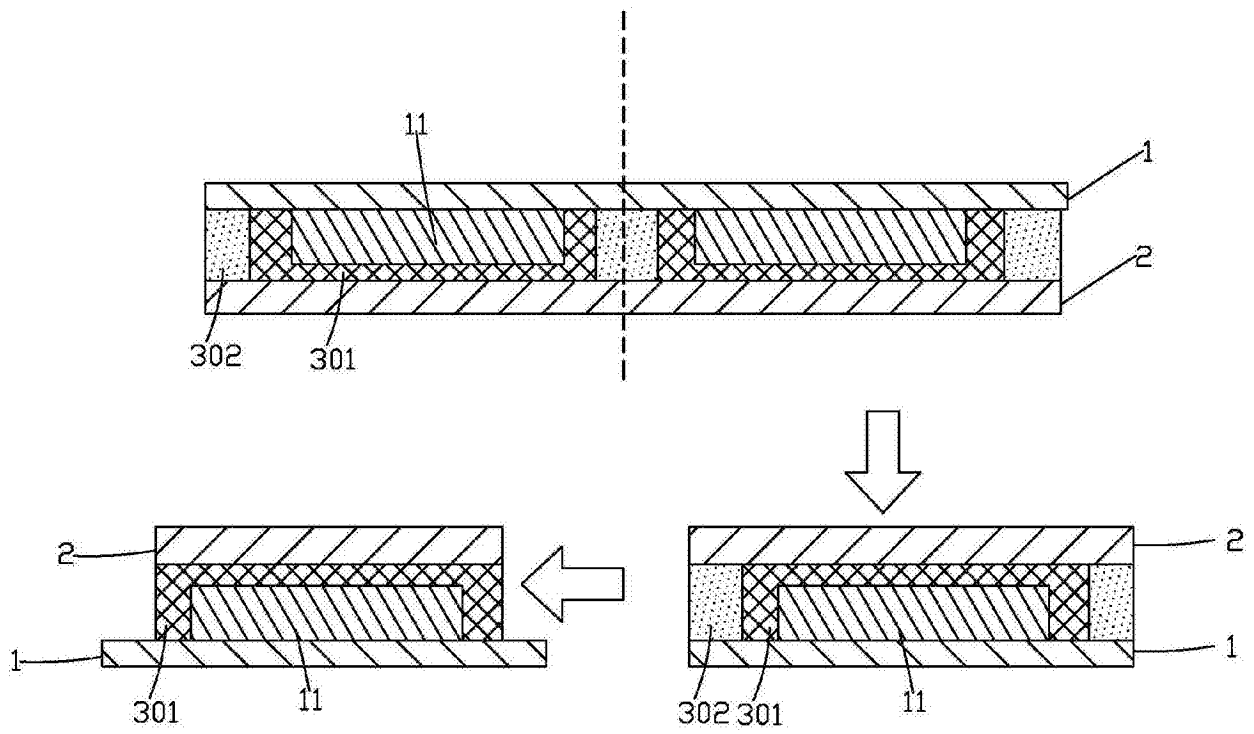


图13

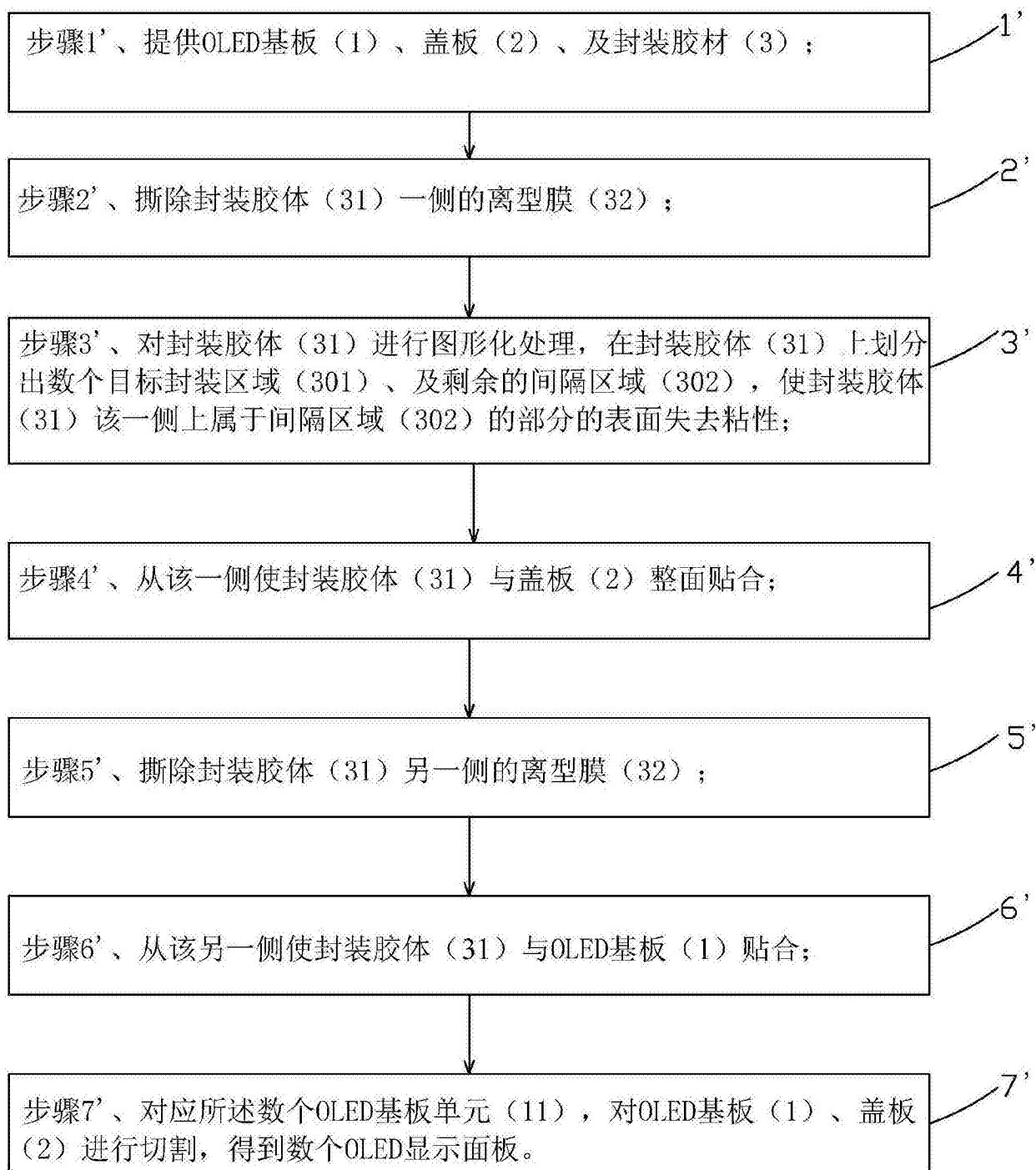


图14

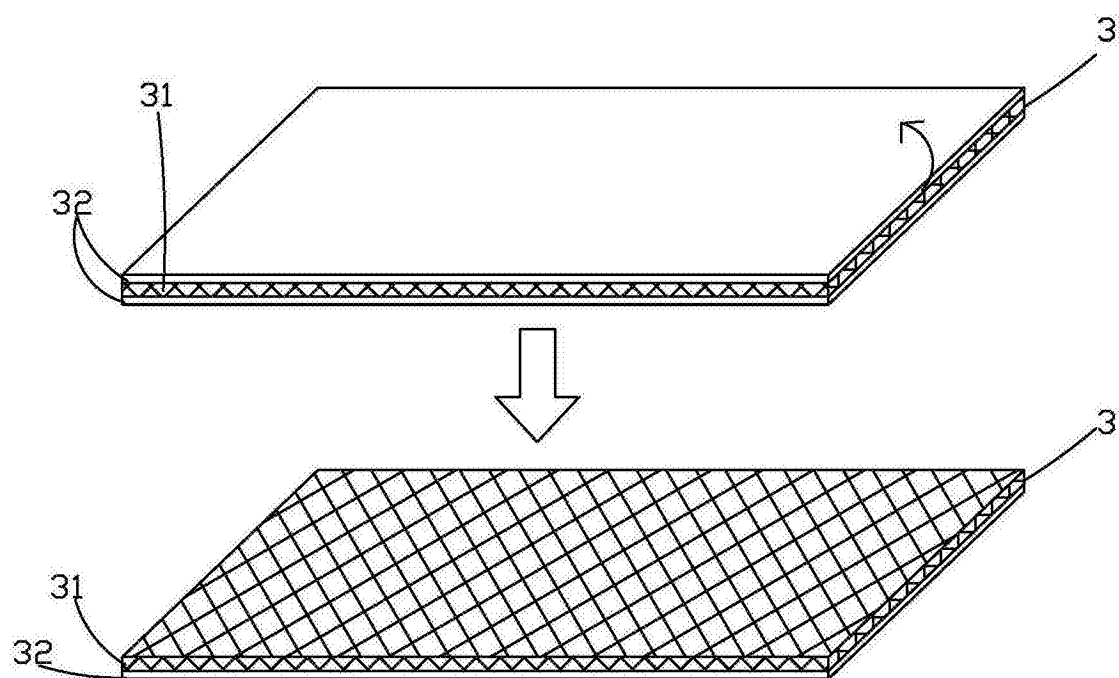


图15

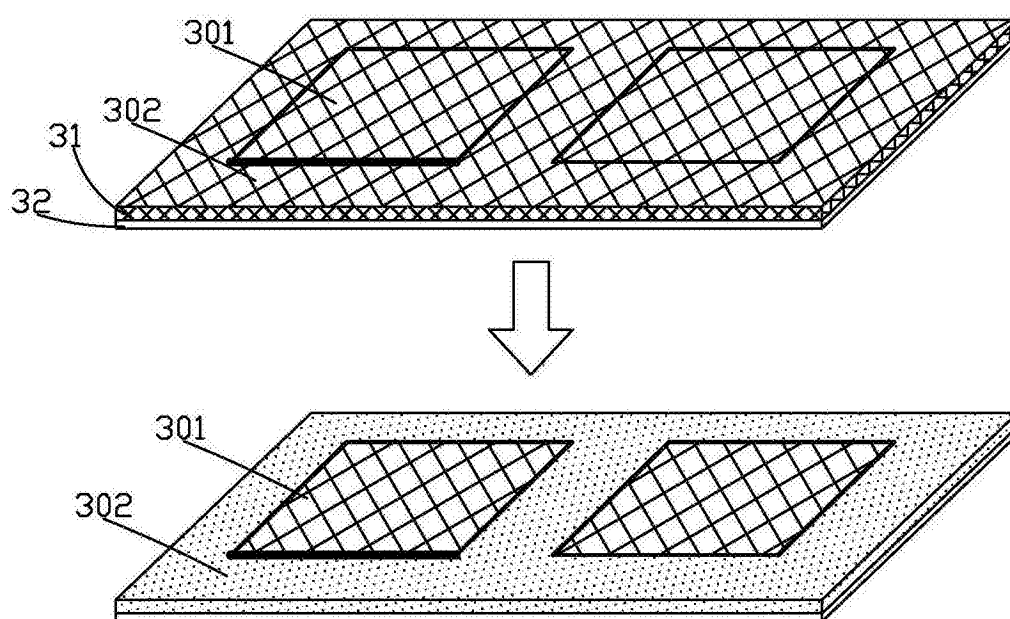


图16

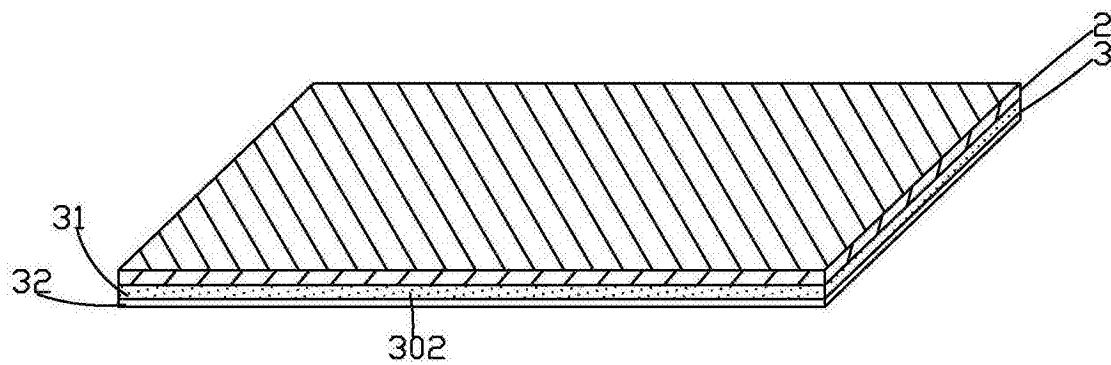


图17

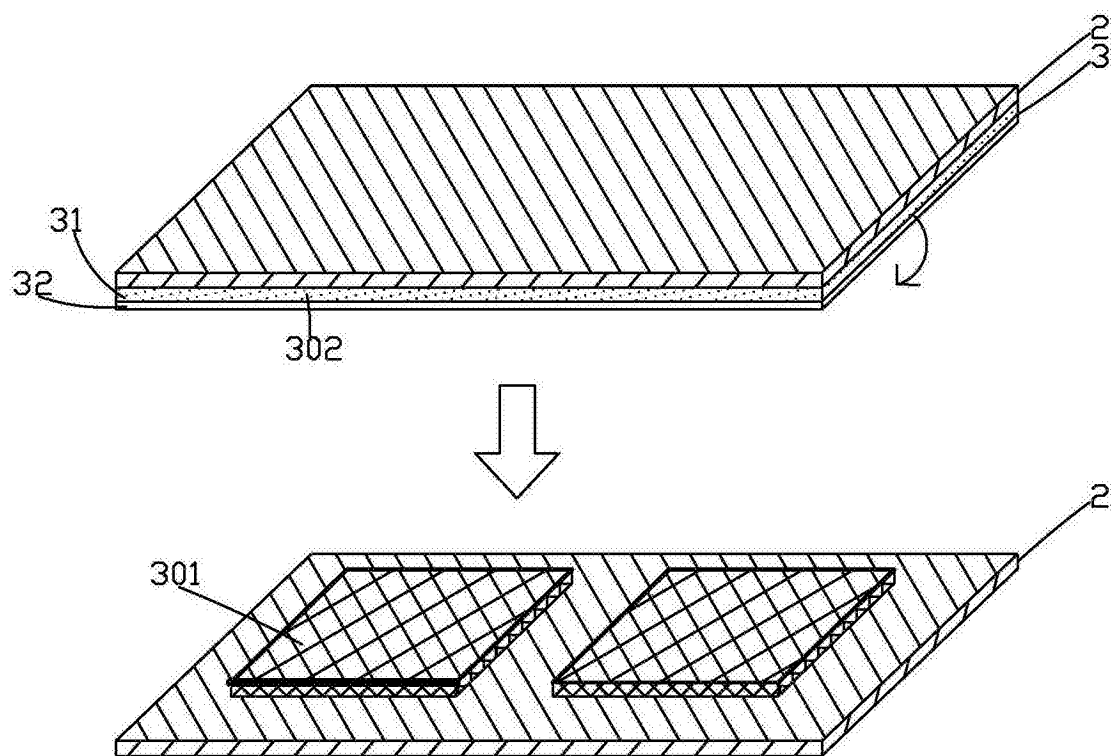


图18

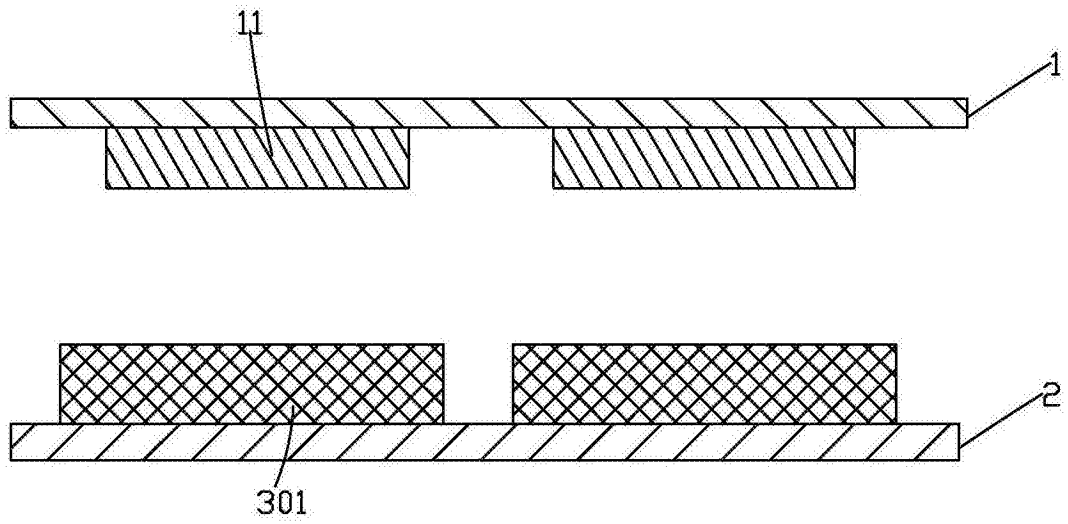


图19

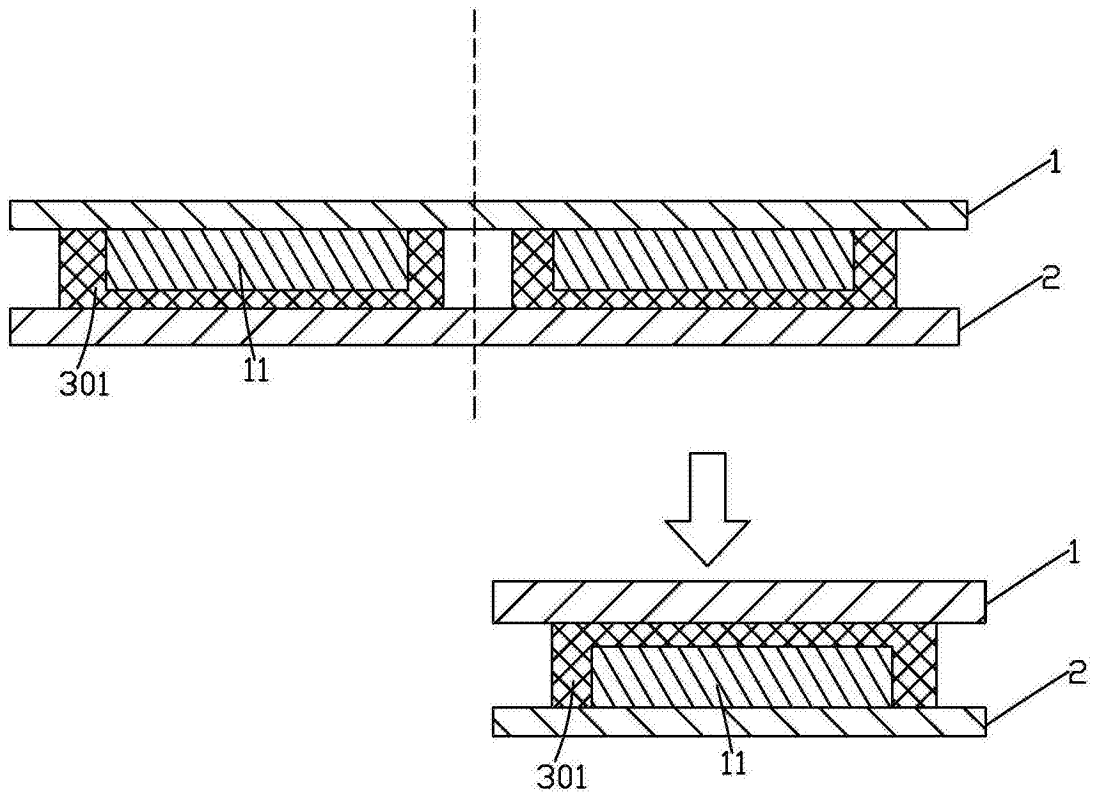


图20

专利名称(译)	OLED显示面板的制作方法		
公开(公告)号	CN106374055A	公开(公告)日	2017-02-01
申请号	CN201610912009.9	申请日	2016-10-19
[标]申请(专利权)人(译)	深圳市华星光电技术有限公司		
申请(专利权)人(译)	深圳市华星光电技术有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	深圳市华星光电技术有限公司		
[标]发明人	曾维静		
发明人	曾维静		
IPC分类号	H01L51/56 H01L51/52 H01L27/32		
CPC分类号	H01L27/3244 H01L51/5237 H01L51/56 H01L2227/323 H01L2251/566		
其他公开文献	CN106374055B		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本发明提供一种OLED显示面板的制作方法，首先对封装胶材的封装胶体进行图形化处理，在所述封装胶体上划分出数个与OLED基板上的数个OLED基板单元一一对应的目标封装区域、及剩余的数个目标封装区域之外的间隔区域，对所述封装胶体上属于间隔区域的部分进行表面破坏处理，而使该部分的表面失去粘性，然后再将封装胶体与OLED基板进行贴合，最后通过切割得到数个OLED显示面板，该方法简单易行，降低了贴合机的尺寸兼容性要求，以及避免了额外机械手、承载治具的使用，从而降低了治具清洗、传输、存放等复杂操作引起的设备巨额成本，提高了产品的对位贴合精度，可实现自动化。

